

无基材高导热双面胶带 XK-TN12 (德国专案)

XK-TN12 导热双面胶带是一种耐高温丙烯酸酯压敏胶填充高导热陶瓷而制成。具有高导热性及中粘接性能，使其电子器件与散热器之间不在需要机械扣具和胶粘剂固定，使用时只需轻压即可立即粘接，其粘接性能、粘接强度随时间和温度和施加压力升高而增强。

XK-TN12 导热双面胶带为无基材,只适合简单形状的产品,并可以预先贴在一个表面上以便将来贴合使用。应用 XK-TN12 应用于 LED 基板,无扣具芯片,柔性电路板及大功率晶体管 and 散热片或其他冷却装置的粘接。



	unit	XK-TN12			Method
Reinforcement Carrier		none	none	None	
Color		White	White	White	visual
Thickness	mm	0.1	0.15	0.20	ASTM D374
Specific Gravity	g/cm ³	2.0	2.0	2.0	ASTM D792
Bonding strength	N/in	>8	>8	>8	ASTM 3330
Thermal impedance	°Cin ² /W	0.40	0.43	0.58	ASTM D5470
Thermal Conductivity	W/mK	> 1.0	>1.0	>1.0	HOT DISK
Volume Resistivity	Ωcm	>10 ¹³	>10 ¹³	>10 ¹³	ASTM D257
Breakdown Voltage	KV	2	3	4	ASTM D149
Dielectric Constant	1	5	5	5	ASTM D150
Application temperature	°C	-30~150	-30~150	-30~150	
Tensile strength	psi	-	-	-	ASTM D149
Elongation	%	-	-	-	ASTM D149
Siloxane Volatiles D4~D20	%	0	0	0	GC-FID